

미주 우수학교 채용 설명회

'11. 3. 21(월)

1. 개요

- ☐ 학 교 : The Ohio State University
- ☐ 일 정 : '11. 4. 5(화)
- ☐ 장 소 : 학교 내 취업 담당자를 통해 별도 안내 예정

2. 채용분야

전공(세부 전공)	
물리, 화학 기계, 전기전자	광학, 기구설계, 시스템 동역학 및 소음/진동, Image/Signal Processing
산업공학	지능형 생산 시스템, 데이터 마이닝
재료/산업공학	고분자 재료 (페인트, 증착, 발포, 성형, 수지, 유기 등 연관), 용접(재질/소재/방법)
전기전자 기계, 산업공학	자동화 시스템 설계, 회로/전장 설계, 전자기학, 전자회로설계, 제어자동화, 전력전자공학
전기전자 컴퓨터공학	영상처리, 컴퓨터공학, 패턴인식, Computer Graphic & HMI, Database & Web Embedded System, S/W설계
응용 분야	
공정_도장	가전 또는 IT 제품의 후가공기술(외관 도장 및 증착) 후가공 메커니즘 설계 및 연관 소재/재료 개발
공정_발포	가전 제품 발포(foaming) 설비 및 소재/재료 선정 및 개발
기초과학	광학, 고주파 브레이징
비전	Machine Vision 응용, Vision Pattern 인식, 광학검사, 검사 프로그램 개발(VC++)
신호처리 시스템 동역학	소음/진동 Signal 처리, Image/Signal Processing
회로설계	Digital/Analog 회로설계, PCB회로 설계
공장자동화	기구 설계 (조립/포장/검사 장비 및 자동화 라인 설계 3년 이상 有경험)
	전장 H/W 및 S/W 개발(조립/포장/검사 장비 및 공정관리 관련 3년 이상 有경험) RFID 응용 (자재 이력, 물류 관리 등)
S/W	Windows 기반 응용 S/W 개발, Embedded 기반(ARM Core) 설계 및 응용 DB 설계 및 응용 (VB 가능), Web기반 S/W 개발(C# 가능), Computer graphic 데이터 마이닝(진단 분석), PLC 프로그래밍 (지멘스, 미쯔비시 등)

3. 향후일정

- ☐ 지원서접수 : '11. 4. 13 ~ 4. 22 (한인회 게시판을 통해 공고등록)
- ☐ 기술면접(Conference Call Interview) : '11. 5. 2 ~ 5. 27
- ☐ 인성면접 : '11. 6월 중 (현지방문)

삼성전자주식회사
제조기술센터

직인
생략